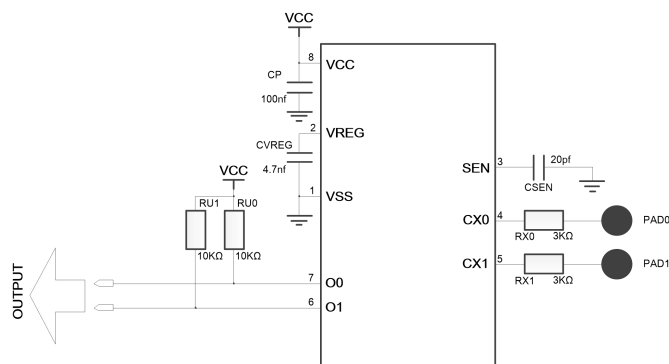


TC332B 双通道低功耗电容触摸芯片

1.特性

- 工作电压范围：2.9V~5.5V
- 待机电流：5 μ A@VDD=3V
- 可由外部电容(CSEN)调整灵敏度
- 最长输出时间约 50 秒
- 按键最长响应时间：待机模式下约 350~750ms，工作电压越高最长响应时间越长
- 自动校准功能，自动校准环境变化
- 抗干扰性能优良
- 系统低成本
- 降低系统复杂度提高稳定性
- 嵌入的共模干扰去除电路
- HBM ESD：大于 8KV
- MMESD：大于 500V
- RoHS 兼容的 SO-8 封装

简化原理图



2.应用

- 智能门锁、空调、洗衣机、微波炉等家电产品
- 工业控制面板、医疗控制面板、数字化白板
- 蓝牙耳机、电子玩具
- 智能家居
- 个人护理产品
- 传统按键替换

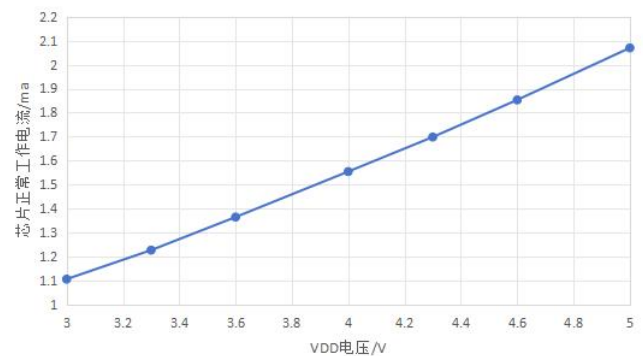
3.说明

TC332B 是一款 2 路低功耗、超强抗 EMC 干扰的电容触摸传感器 ASIC 芯片，可以广泛的满足不同消费类应用的要求。内嵌自有核心技术的超强抗干扰电路，具有快速自电容感应技术，实现极高灵敏度和低待机功耗，同时降低系统复杂度和提高产品稳定性。

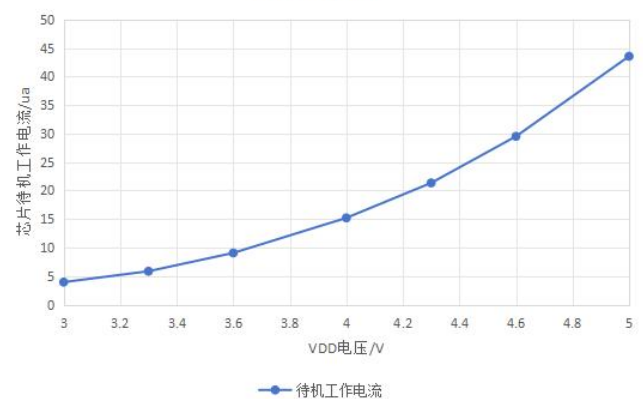
此器件采用 SO-8 封装。

功耗情况 (3~5V)

正常工作电流



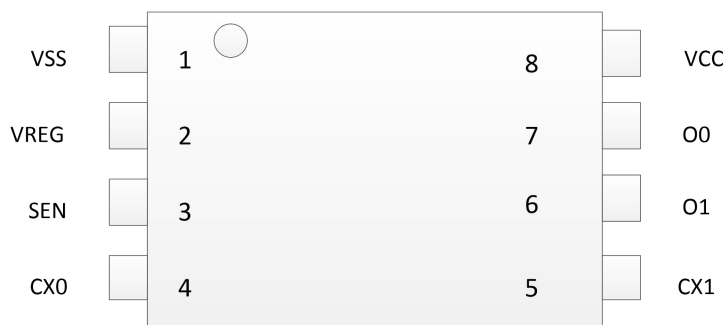
待机工作电流



目录

1.特性	1
2.应用	1
3.说明	1
4.管脚图示	3
5.管脚描述	3
6.芯片功能	4
6.1 初始化时间	4
6.2 灵敏度	4
6.3 自校正	4
6.4 触摸反应时间	4
6.5 输出逻辑	4
6.6 睡眠模式	4
7.应用原理图	5
8.模拟电压输出	5
9.PCB 版图注意事项	5
10.额定值	6
11.电气特性	6
12.ESD 特性	6
13.封装尺寸图 (SO-8)	7

4.管脚图示



5.管脚描述

引脚	名称	输入/输出	描述
1	VSS	电源负极	地参考
2	VREG	模拟输出	内部参考源输出
3	SEN	模拟输入输出	灵敏度电容
4	CX0	模拟输入输出	感应天线 0
5	CX1	模拟输入输出	感应天线 1
6	O1	输出	按键 1 输出
7	O0	输出	按键 0 输出
8	VCC	电源正极	供电电压输入
引脚	名称	输入/输出	描述

SEN

此管脚电容大小为15pf~100pf, 电容越小灵敏度越高。

VREG

内部参考源输出, 接4.7nf电容。

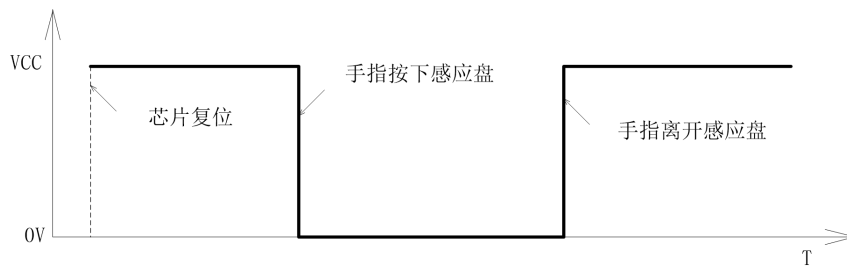
CX0, CX1

感应天线 ,串联电阻是3KΩ。

O0, O1

CX0, CX1的相应输出端口, 有高阻和低电平两种状态。

00, 01 电压（外接上拉电阻）



6. 芯片功能

6.1 初始化时间

上电复位后，芯片需要300ms进行初始化，计算感应管脚的环境电容，然后才能正常工作。

6.2 灵敏度

灵敏度由SEN端口接的电容值决定。数值越小，灵敏度越高。

6.3 自校正

根据外部环境温度和湿度等的漂移，芯片会一直调整每个按键的电容基准参考值。从检测到按键开始，芯片会停止校正一段时间，这段时间大约50秒。然后芯片会继续自校正，也就是说检测按键有效的时间不会超过50秒。

6.4 触摸反应时间

每个通道大约每隔4.5ms采样一次。经过按键消抖处理以后，检测到按键按下的反应时间大概是25毫秒，检测按键离开的反应时间大概是20毫秒。所以检测按键的最快频率大概是每秒18次。

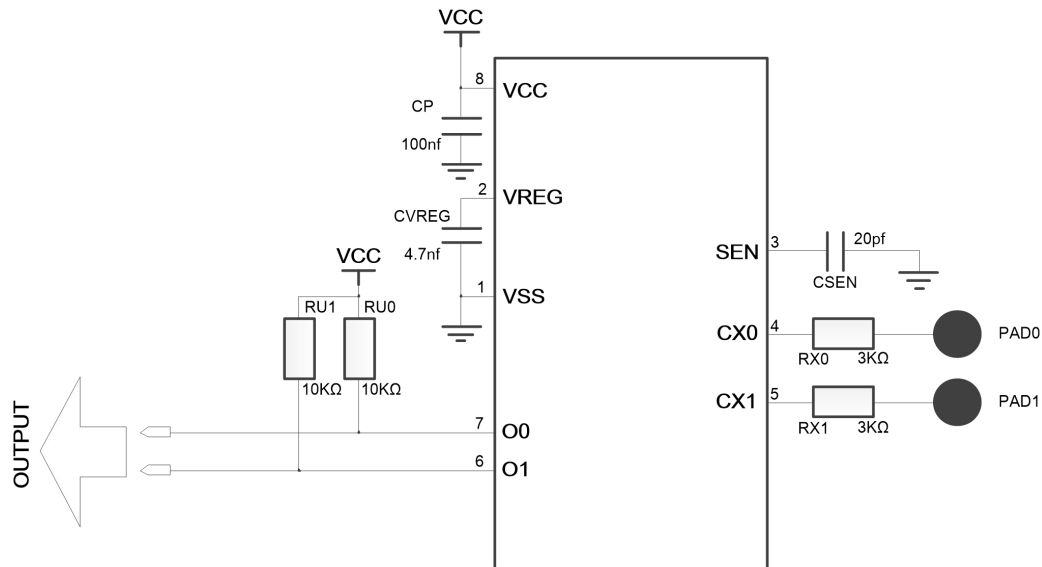
6.5 输出逻辑

输出端口O0~O1，有两种状态，高阻或低电平。无按键时为高阻，检测到按键时为低电平。

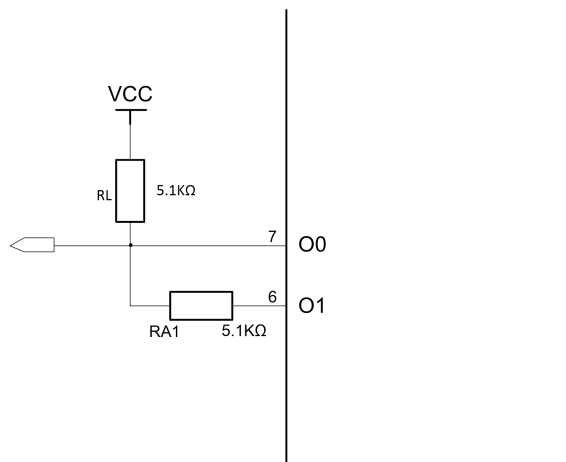
6.6 睡眠模式

如果在一段时间内（15秒左右）没有检测到按键，芯片会自动进入省电模式。在睡眠模式中，按键的采样间隔会变长，电流消耗（I_{dd}）会减小。如果检测到按键，芯片会马上离开睡眠模式，进入正常模式。

7.应用原理图



8.模拟电压输出



感应盘	O0	O1	AO 输出电压
感应盘 0(CX0) 按下	低电平	高阻	0v
感应盘 1(CX1) 按下	高阻	低电平	0.5*VCC
无按键	高阻	高阻	VCC

9.PCB 版图注意事项

1. VCC 和 VSS 电源线要单独走线，不能和其它芯片（单片机和 LCD 驱动芯片等）共用电源走线。以免使其它芯片的干扰信号通过电源线引到触摸芯片。
2. CP，CVREG，CSEN 三个电容必须靠近芯片放置。感应线上串联的 CX0~CX1 电阻，靠近芯片放置为宜。

3. 尽量大的铺地面积，可以提高抗干扰性。

4. 感应连线 and 感应焊盘优先布局。芯片靠近感应焊盘放置，感应连线直接引到感应焊盘（或弹簧焊盘），不同按键的感应连线不需要长度一致。感应连线线宽尽量小。感应连线周围不能走其他电源线和信号线。如果实在不能避免，其他走线要垂直跨过感应连线。感应焊盘之间至少留 5mm 间距，感应焊盘和铺地之间距离大于 1.5mm。

10. 额定值

工作温度	-40 ~ +85°C
存储温度	-50 ~ +150°C
电源电压	-0.3 ~ +6.5V
管脚最大电流	±20mA
管脚电压	-0.3V ~ (Vcc+ 0.3) Volts

* 注意 超出额定值可能会导致芯片永久损坏

11. 电气特性

TA = 25°C

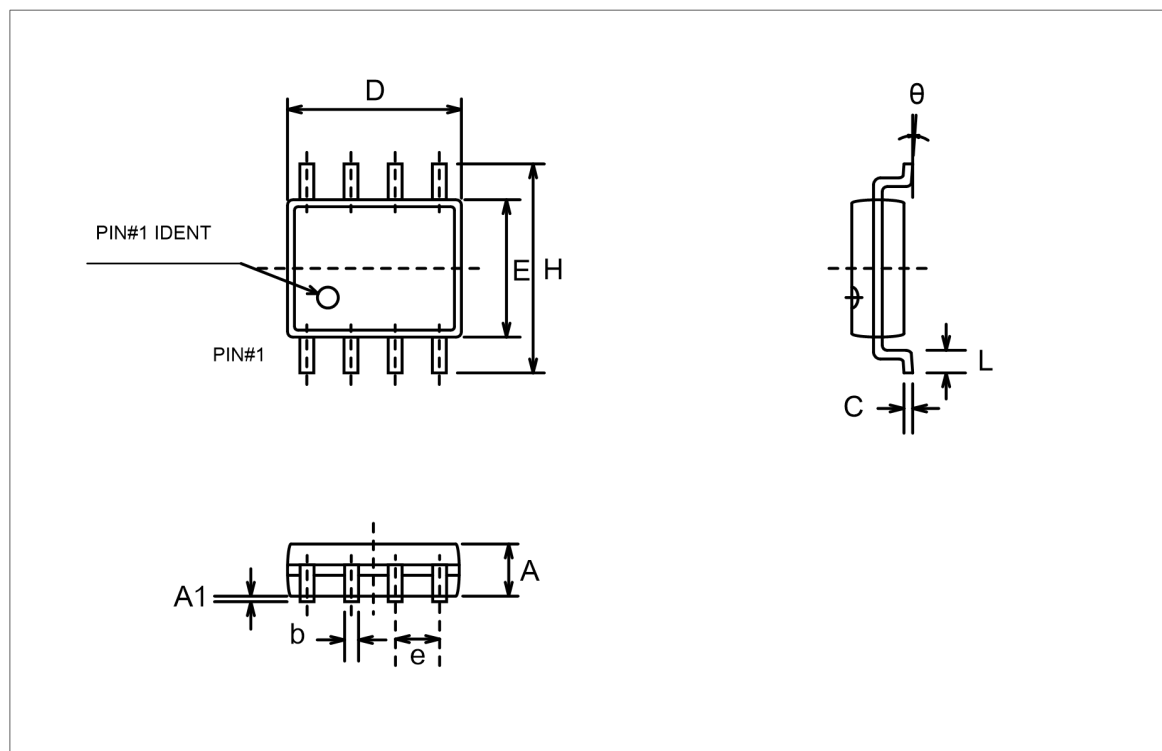
特性	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	Vcc		2.9		5.5	V
电流消耗	Idd	VCC=5.0V		2.1		mA
		VCC=3.0V		1.2		mA
		VCC=5.0V &SLEEP		42		UA
		VCC=3.0V &SLEEP		5		UA
上电稳定时间	Tini			120		ms
感应电容范围	CX				2.5*CSEN	
输出阻抗 (开漏输出)	Zo	低电平		50		Ohm
		高阻		100M		
输出灌电流	Isk	VCC=5V			10.0	mA
最小检测电容	delta_CX	CSEN=15pf		0.2		pF
采样周期	Tsi	正常工作状态		4.5		ms
进入空闲时间	Tidle	无按键		15		s

12. ESD 特性

模式	极性	最大值	参考
H.B.M	POS/NEG	8000V	VDD
		8000V	VSS

		8000V	P to P
M.M	POS/NEG	500V	VDD
		500V	VSS
		500V	P to P

13.封装尺寸图 (SO-8)



符号	毫米单位			英寸单位		
	最小	典型	最大	最小	典型	最大
A	1.30	1.50	1.70	0.051	0.059	0.067
A1	0.06	0.16	0.26	0.002	0.006	0.010
b	0.30	0.40	0.55	0.012	0.016	0.022
C	0.15	0.25	0.35	0.006	0.010	0.014
D	4.72	4.92	5.12	0.186	0.194	0.202
E	3.75	3.95	4.15	.0148	0.156	0.163
e	--	1.27	--	--	0.050	--
H	5.70	6.00	6.30	0.224	0.236	0.248
L	0.45	0.65	0.85	0.018	0.026	0.033
θ	0°	--	8°	0°	--	8°